

东芯半导体股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员等主体投保责任保险及招股说明书责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为合理控制并管理公司董事、高级管理人员及相关人员的管理风险和法律风险，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）附录C1《企业管治守则》第二部分第C.1.7条守则条文的要求及相关的境内外法律、法规及规范性文件及行业惯例，公司拟购买董事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险（以下简称“董高责任险”）。现将有关事项公告如下：

一、投保方案主要内容

- 1、投保人：东芯半导体股份有限公司；
- 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（最终以签订的保险合同为准）；
- 3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（最终以签订的保险合同为准）；
- 4、保费总额：不超过人民币80万元/年（最终以签订的保险合同为准）；
- 5、保险期限：
 - （1）公司及董事、高级管理人员以及相关责任人员的责任保险：保险期限12个月（后续每年可续保或重新投保）；
 - （2）招股说明书责任险：保险期限不超过72个月；最终以签订的保险合同为准。

本次购买董高责任险事项已提请股东会授权董事会及/或其授权人士在遵循经

不时修订的《香港联交所上市规则》附录C1《企业管治守则》的要求及其他境外相关规定及市场惯例，并参考行业水平的前提下办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

2026年5月22日，公司分别召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议、第三届董事会第十二次会议审议了《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》。

根据《上市公司治理准则》等相关规定，因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2026年第二次临时股东会进行审议。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026年5月23日